

『パナソニックグループ 除外項目一覧表』

- 1) コンパクト蛍光ランプに含まれる水銀であって、ランプあたり 5 mg を超えないもの
- 2) 一般照明用の直管形蛍光ランプに含まれる水銀であって、次の使用量を超えないもの：
 - － ハロリン酸カルシウム系蛍光体を使用したランプ 10 mg
 - － 3波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ 5 mg
 - － 3波長形蛍光体を使用した長寿命のランプ 8 mg
- 3) 特殊用途用の直管蛍光ランプに含まれる水銀
- 4) ここに記載されていないその他のランプに含まれる水銀
- 5) ブラウン管、電子部品及び蛍光管のガラスの中に含まれる鉛
- 6) 鉛含有量 0.35 wt% (質量比、以下同じ) 以下の鉄、鉛含有量 0.4 wt% 以下のアルミニウム及び鉛含有量が 4 wt% 以下の銅合金に合金成分として含まれる鉛
- 7) 次の中に含まれる鉛
 - － 高融点温度はんだに含まれる鉛 (例えば、鉛を 85 wt% 以上含む鉛はんだ合金)
 - － サーバー、記憶装置・記憶アレイシステム、信号切替え・送受信・伝送及び電気通信ネットワーク管理用のネットワーク基盤設備向けに用いられる、はんだに含まれる鉛
 - － 電子セラミック部品に含まれる鉛 (例えば、 piezoelectronic デバイス)
- 8) 電気接点中のカドミウム及びその化合物、並びに特定の危険物物質及び調剤の販売及び使用を制限することを規定した指令 (76/769/EEC) の修正指令 (91/338/EEC) で禁止されている用途を除いたカドミウムめっきに含まれるカドミウム及びその化合物
- 9) 吸収式冷蔵庫の炭素鋼製冷却システムの防せい (錆) 処理としての六価クロム
- 10) 鉛青銅製の軸受胴及びブッシングに含まれる鉛
- 11) コンプライアント・ピン・コネクタシステムに用いる鉛
- 12) 熱伝導モジュール形 C リング向けコーティング材料としての鉛
- 13) 光学ガラス及びフィルタガラス中に含まれる鉛及びカドミウム
- 14) マイクロプロセッサのピン及びパッケージ間の接合用に用いる鉛含有量 80 wt% を超え、かつ、85 wt% 未満の 2 種類以上の元素で構成されるはんだの鉛
- 15) 集積回路パッケージ (フリップチップ) の内部半導体ダイ及びキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛